

2025年 法人說明會

財務長 邱智芳 2025.08.28

股票代號：3444

發言人：盧修滿協理 / claire@niching.com.tw

代理發言人：邱智芳協理 / chris@niching.com.tw

股務聯絡人：陳玲芝課長 / cherry@niching.com.tw

投資安全聲明

本內容可能包含「前瞻性陳述」，包括(但不限於)未來展望、預測及估算等預期性之陳述。這些前瞻性陳述乃基於本公司經營的信念及對於未來的目前看法。這些看法可能受到內外在風險及不確定性因素影響，有造成實際結果與陳述內容顯著不符之可能。

本文件所做出的任何前瞻性陳述僅於陳述日當日適用，投資者應有自主判斷，不應過分依賴該等前瞻性陳述。對於這些看法，除法規規定外，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。本節所述的警告聲明適用於本簡報所載的所有前瞻性陳述。



公司簡介

創 立：1993年

資本額：4.5億

上櫃時間：2008年

營業據點：



台中總公司



新竹分公司

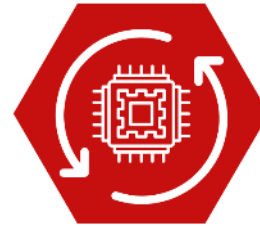


高雄分公司



蘇州分公司

營業項目：



通路代理

半導體、FPD、LED相關材料、
零件與設備



自有研發與製造

1. 低溫燒結銀膠
2. 高導熱銀膠
3. 網印銀漿
4. 客製化銀漿



營運報告

(2025 Q2)

綜合損益表

2025年
Q2

(NT\$仟元)	2021	2022	2023	2024	Q1 2025	Q2 2025	QoQ	YoY
營業收入	1,218,919	1,060,398	976,397	1,153,486	301,151	322,585	7%	7%
營業毛利	310,457	310,949	255,756	284,926	72,596	70,956	-2%	-4%
毛利率	26%	29%	26%	25%	24%	22%	-9%	-10%
營業淨利	150,568	124,057	75,279	78,293	22,457	27,255	21%	24%
營業外收(支)	15,294	110,067	36,565	65,185	19,679	(12,304)	-163%	-185%
稅前淨利	165,862	234,124	111,844	143,478	42,136	14,951	-65%	-59%
本期淨利	134,428	195,976	93,545	107,452	35,650	18,657	-48%	-43%
淨利率	11%	18%	10%	9%	12%	6%		
EPS (NT\$) 註:	3.36	4.90	2.12	2.39	0.79	0.41	-48%	-44%

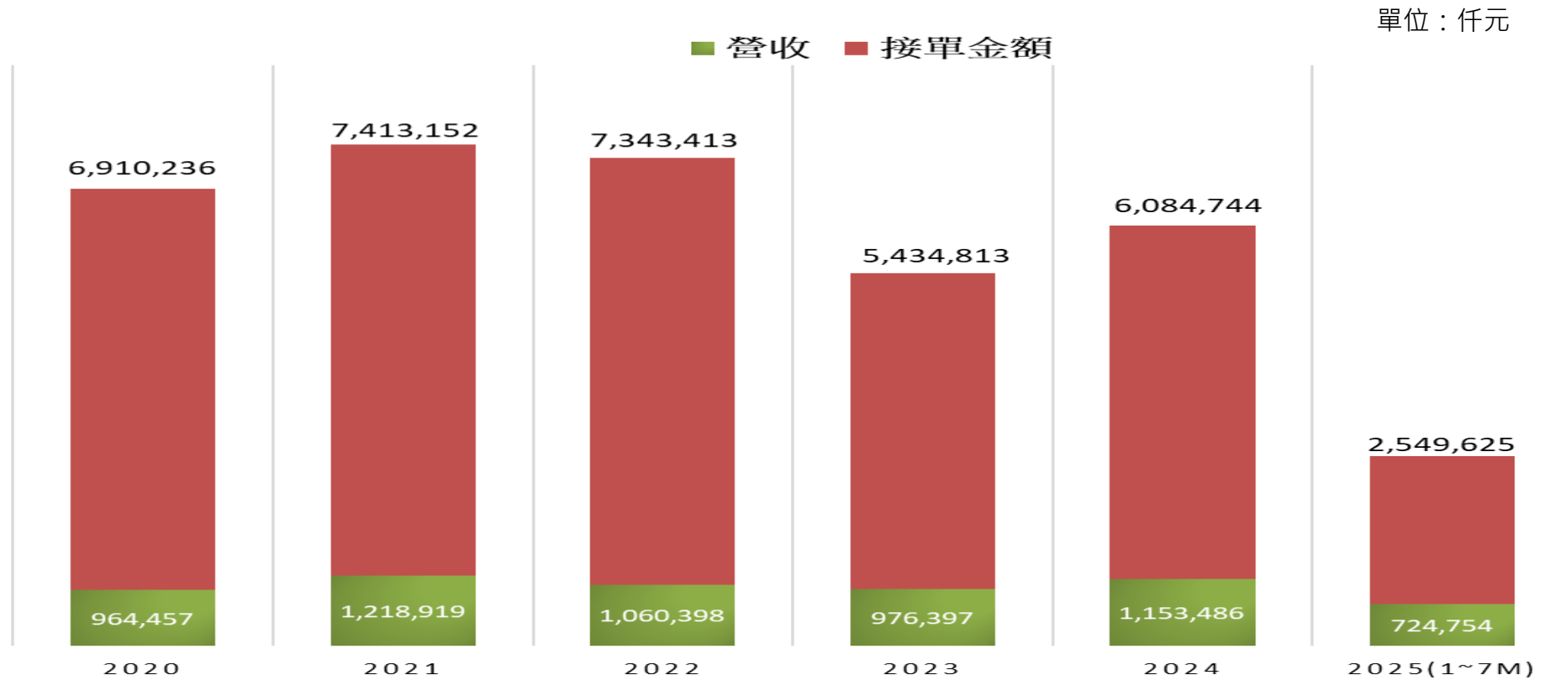
註：係追溯調整後

資產負債表

NT\$仟元	2022	2023	2024	Q2 2025
資產				
現金及約當現金	327,431	398,797	333,159	493,784
應收帳款	532,247	443,432	550,367	491,053
存貨	60,048	67,008	60,611	50,390
轉投資相關	257,247	263,434	252,910	86,602
不動產、廠房及設備	226,154	223,341	286,419	285,704
其他資產	26,539	34,288	29,040	51,314
資產總計	1,429,666	1,430,300	1,512,506	1,458,847
負債				
短期借款	150,000	-	-	-
應付帳款	227,968	233,559	315,611	286,909
其他負債	131,435	110,272	122,610	174,808
負債總計	509,403	343,831	438,221	461,717
權益總計	920,263	1,086,469	1,074,285	997,130
淨值 (NT\$元 /股)	23.53	24.63	23.87	22.16

歷年營收/接單金額

2025年(1-7月)累計營收已達2024年全年營收62.8%，2025年全年營收有望創歷史新高。

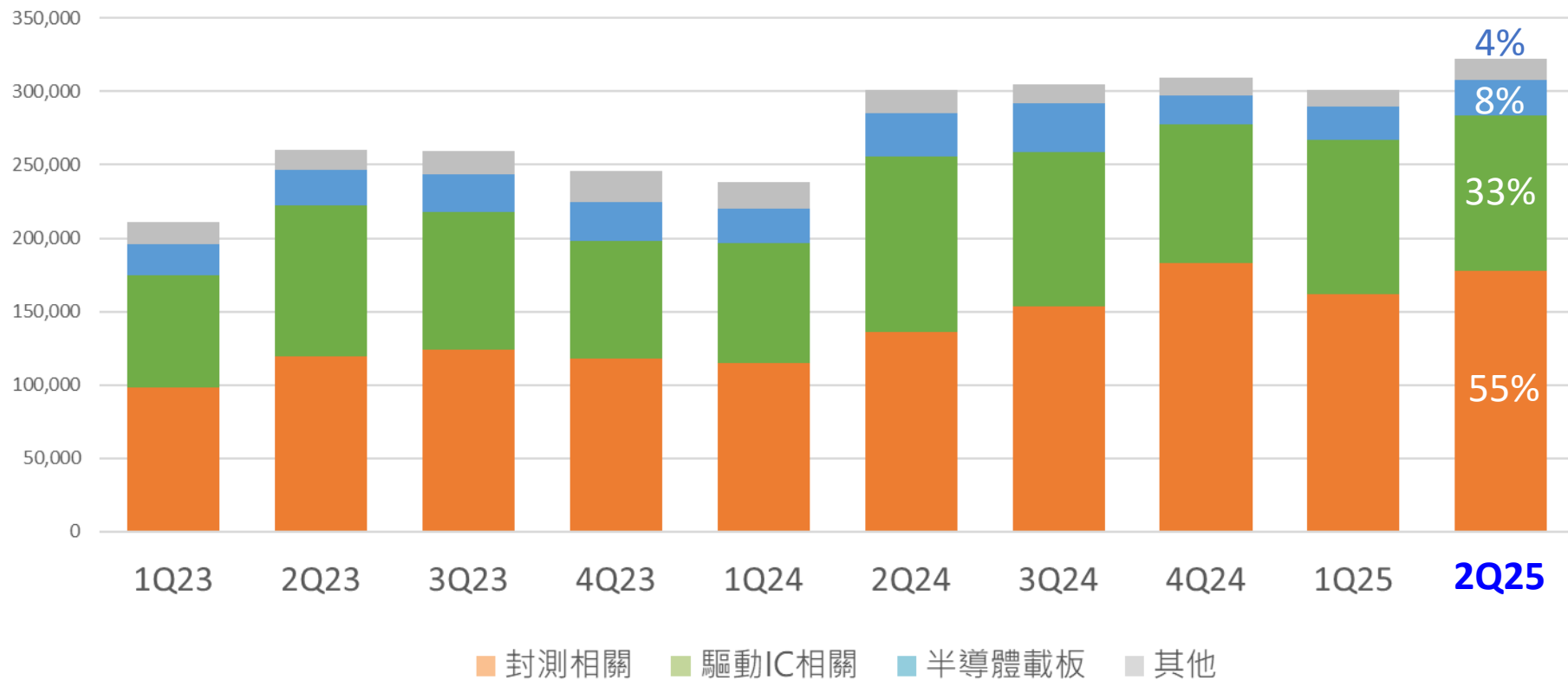


說明： 營收模式：分為買賣模式(營收全部認列)及佣金模式(僅佣金收入認列)

接單金額=訂單總金額(銷售模式+佣金模式)

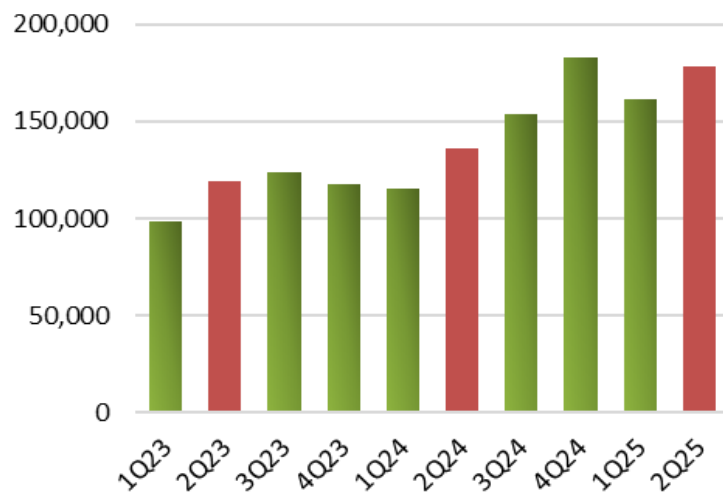
整體季度營收

- 主力產品營收占比: 封測相關50~55%、驅動IC相關30~35%、半導體載板7~10%。



封測相關

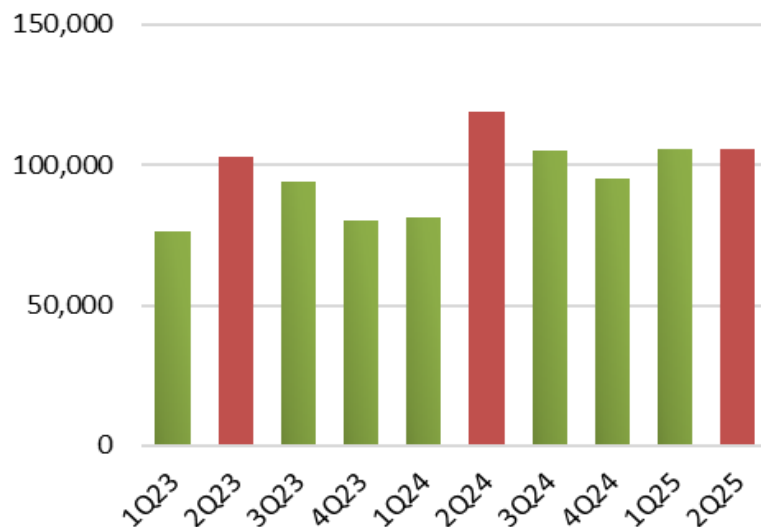
YoY 31% , QoQ 10%



拉貨效應 + AI推升散熱需求

驅動IC

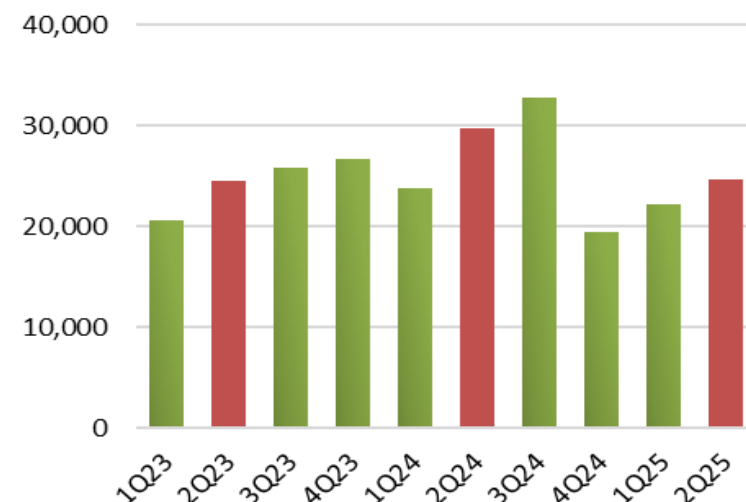
YoY-11%、QoQ 持平



終端應用需求未復甦，以去庫存為主

半導體載板

YoY -17%、QoQ 11%



因AI需求、客戶拉貨，訂單爆單



營運展望

策略一：整合材料解決方案

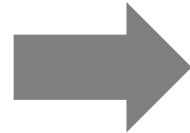
1.載板成長策略

垂直整合服務



Team STN

■ 銷售能力 ■ 技術能力

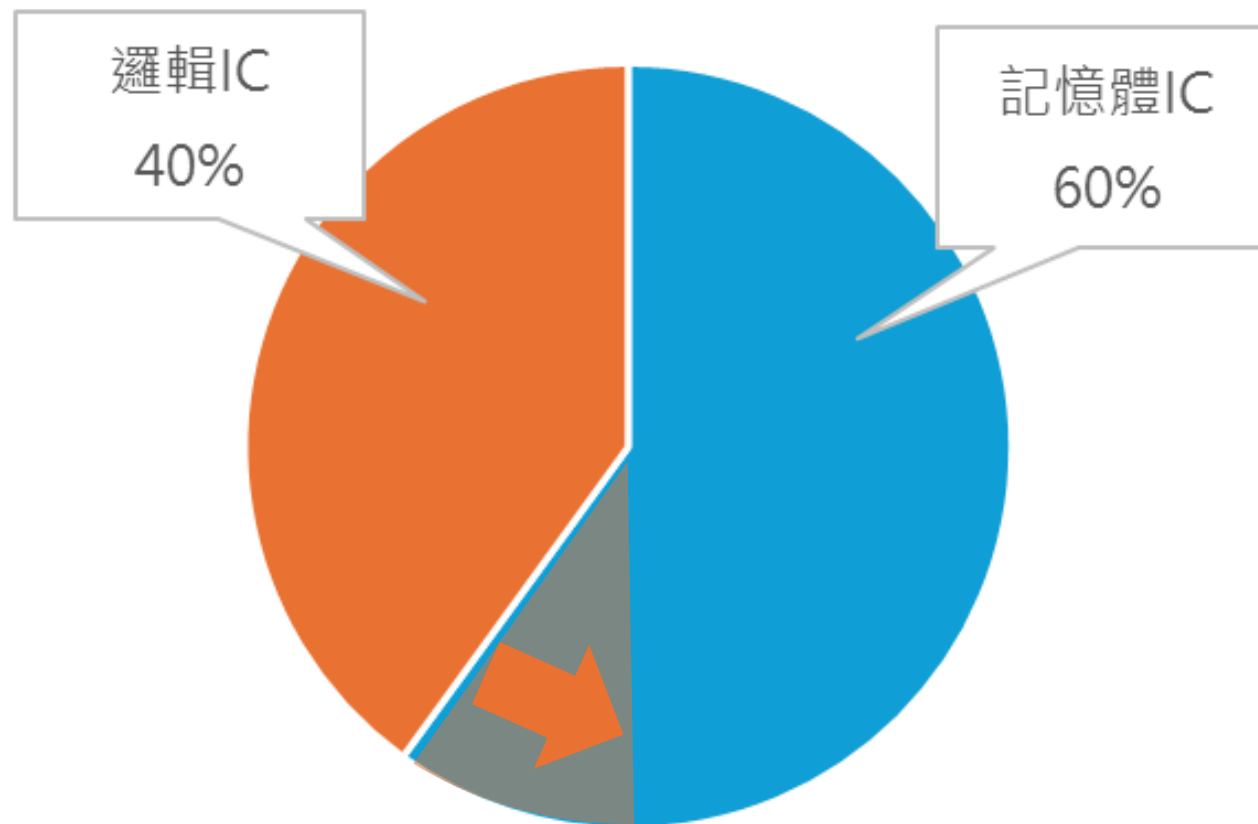


- 強化與Simmtech關係
- 擴大邏輯IC 載板市場



策略一：整合材料解決方案

2025年半導體載板接單佔比



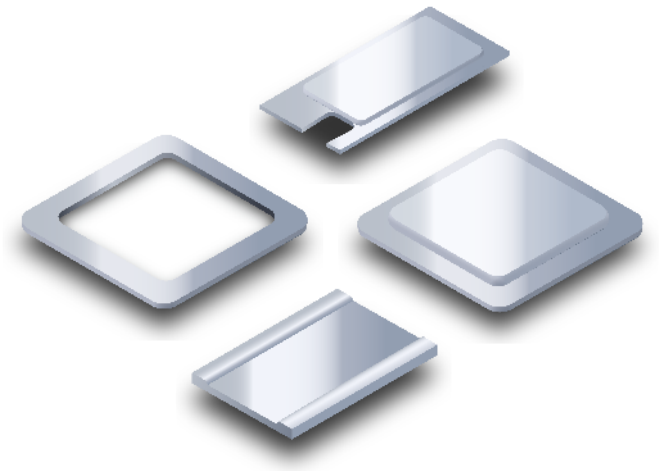
策略一：整合材料解決方案

2.均熱片成長策略

垂直整合技術



策略一：整合材料解決方案



均熱片布局趨完整

尺寸齊全、客製化生產，聚焦大尺寸、先進封裝。

應用領域	尺寸	技術門檻	售價	利機優勢
消費性 IC	小片	低	低	•具 銅材/鋁材/不鏽鋼 高精密沖壓技術，客製化生產 •台系封裝廠的合格供應商
Wireless AP	大片 40*40mm以上	高	高	
伺服器				
CPU/GPU				

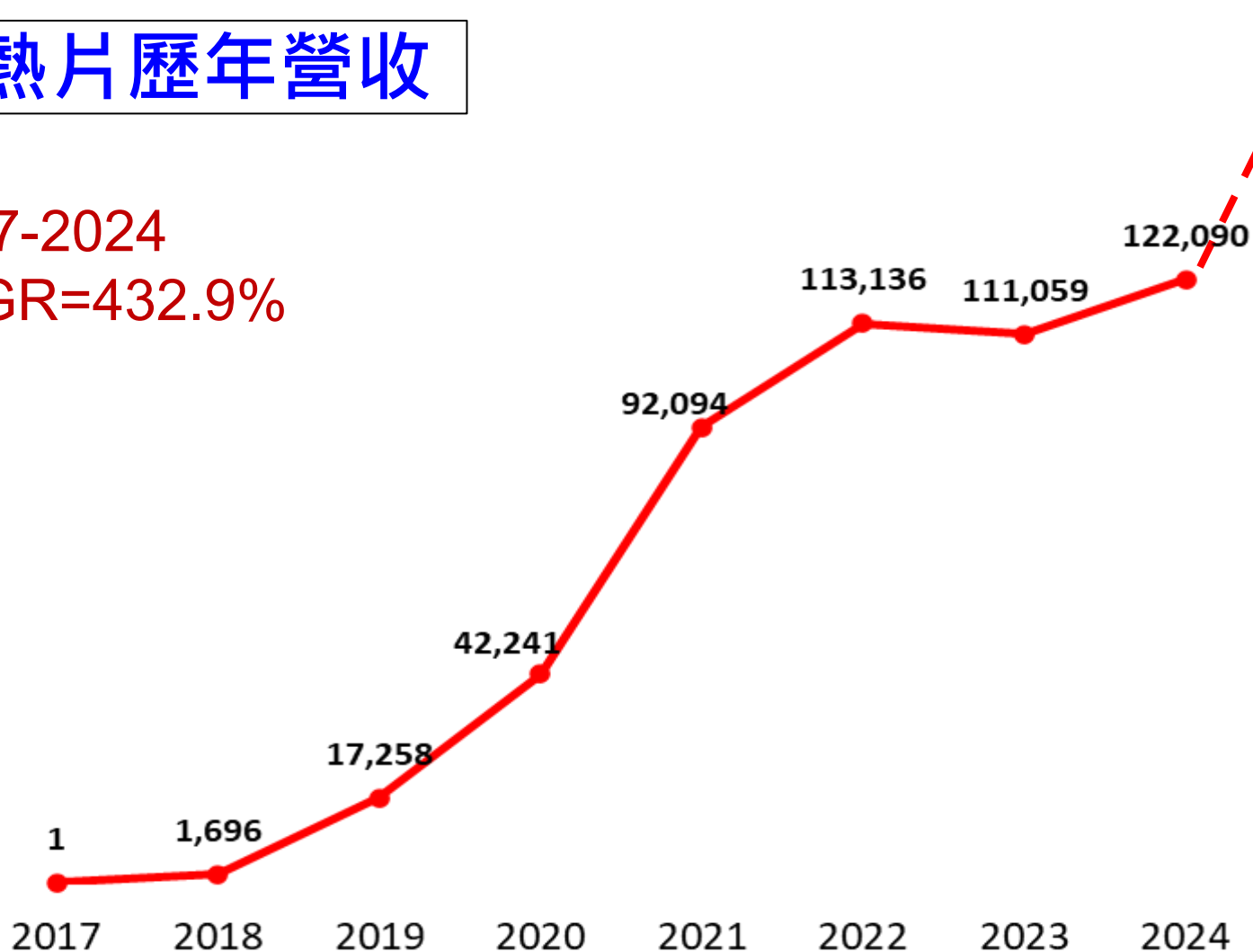
策略一：整合材料解決方案

2025 YoY>80%

均熱片歷年營收

2017-2024
CAGR=432.9%

單位：仟元



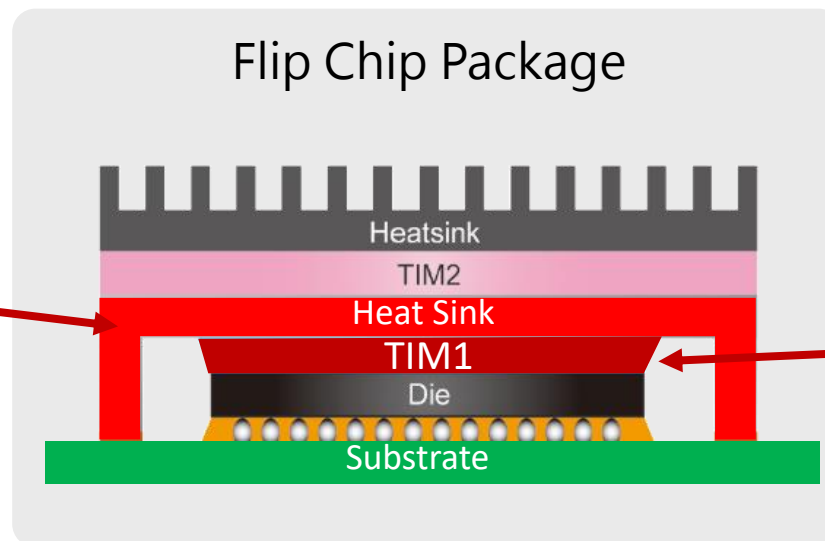
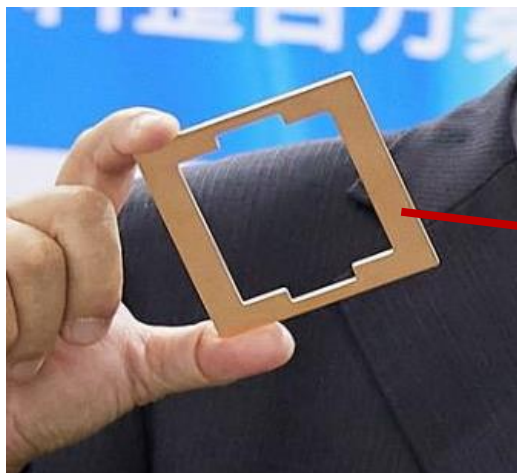
- 2025 1-7月累計YoY=169%
- 下半年通訊、AI伺服器需求
量增。上、下半年營收佔比
約為40：60
- 全年營收有望創歷史新高



3. IC散熱解決方案

因應AI新應用、高階封裝需求帶動散熱相關市場的成長

均熱片



銀漿





自有銀漿研發

客製化銀漿

IOT



1. 快速固化
2. 高導電性
3. 低功率損耗

燒結銀膠

車用電子



1. 高附著強度
2. 高信賴性

IGBT / GaN / SiC



1. 適用大尺寸
($> 8 \times 8$ MM) 晶片
2. 超高散熱性
(> 200 W/MK)

高功率LED



1. 超高散熱性
($150 \sim 200$ W/MK)
2. 高信賴性
3. 175°C 燒結銀

高導熱銀膠

MOSFET



1. 高導熱性
2. 高韌性
3. 高信賴性

策略二：發展自有先進材料



燒結銀成長策略

聚焦、突破、成長三部曲

1. 聚焦優勢技術(固化技術)、拓展產品線
2. 選擇重點客戶、集中資源深耕具有成長潛力的市場



- 初期：客戶應用以光學類為主。
- 中期：針對國際重點客戶提供客製化服務。
- 長期：跨入車用領域。

產品別發展概況

- 持續受惠AI推升散熱需求，均熱片下半年需求更旺，全年營收可望創歷史新高，挹注整體營收。
- 終端市場尚未明顯復甦，短期以去庫存為主。
- 受惠於AI、HPC等需求驅動，迎來全面性的溫和復甦與技術升級週期。LPDDR5X、GDDR7 下半年導入市場。
- 燒結銀膠、客製化銀膠: Q4台灣客戶有機會進入小量產。
- 燒結銀膠: 配合國內封裝大廠、車用大廠驗證中。
- 切割刀具與國內封裝大廠進行測試中。
- 持續評估先進封裝材料與技術，積極佈局未來成長動能。

封測相關

均熱片
導線架
錫針
封裝零組件

驅動IC

Reel
Emboss
Chip Tray

載板

記憶體IC
邏輯IC

銀漿

網印銀漿
客製化銀漿
燒結銀銀漿
導熱銀漿

其他

真空閥門
切割刀具
機台設備與維修
O-LED

THANK YOU

